

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年9月30日
【会社名】	株式会社SUMCO
【英訳名】	SUMCO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役 会長兼CEO 橋本 真幸
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目2番1号
【電話番号】	03-5444-0808
【事務連絡者氏名】	社長室経理部長 伊藤 洋
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目2番1号
【電話番号】	03-5444-0808
【事務連絡者氏名】	社長室経理部長 伊藤 洋
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式
【届出の対象とした募集金額】	一般募集 32,224,500,000円 (注) 募集金額は、発行価額の総額であり、2021年9月22日 (水)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。 ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。
【安定操作に関する事項】	1 今回の募集に伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。 2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

種類	発行数	内容
普通株式	15,000,000株	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 なお、単元株式数は100株です。

(注) 1 2021年9月30日(木)開催の取締役会決議によります。

2 上記発行数は、2021年9月30日(木)開催の取締役会において決議された公募による新株式発行の発行株式総数60,000,000株の一部であり、国内における一般募集(以下「国内一般募集」といいます。)によるものであります。国内一般募集とは別に、海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限ります。)における募集(以下「海外募集」といいます。)が行われます。

なお、公募による新株式発行に際しては、国内一般募集株数(新規発行株式の発行数)15,000,000株及び海外募集株数45,000,000株(海外引受会社による買取引受けの対象株数37,174,000株及び海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の対象株数7,826,000株)を目処に募集を行いますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、後記「2 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載の発行価格等決定日に決定します。

海外募集の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 本邦以外の地域における当社普通株式の募集について」をご参照ください。

3 国内一般募集及び海外募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 ロックアップについて」をご参照ください。

4 振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

(注) 2021年10月11日より「東京都中央区日本橋兜町7番1号」に変更されます。

2【株式募集の方法及び条件】

2021年10月12日(火)から2021年10月15日(金)までの間のいずれの日(以下「発行価格等決定日」といいます。)に決定される発行価額にて後記「3 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で国内一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、国内一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。

(1)【募集の方法】

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当	-	-	-
その他の者に対する割当	-	-	-
一般募集	15,000,000株	32,224,500,000	16,112,250,000
計(総発行株式)	15,000,000株	32,224,500,000	16,112,250,000

(注) 1 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。

2 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。

3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。

4 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2021年9月22日(水)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

(2)【募集の条件】

発行価格(円)	発行価額(円)	資本組入額(円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金(円)	払込期日
未定 (注)1、2 (発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件とします。)	未定 (注)1、2	未定 (注)1	100株	自 2021年10月18日(月) 至 2021年10月19日(火) (注)3	1株につき発行価格と同一の金額	2021年10月21日(木) (注)3

(注)1 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需要状況等を勘案した上で、2021年10月12日(火)から2021年10月15日(金)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に、国内一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(会社法上の払込金額であり、当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取る金額)及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は前記「(1)募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「1 新規発行株式」に記載の発行数で除した金額となります。

今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、引受人の引受株式数及び引受人の手取金をいいます。以下同じ。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(新規発行株式の発行数(国内一般募集株数)、海外募集株数、海外引受会社の買取引受けの対象株数、海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の対象株数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額、海外募集の手取概算額上限及び手取概算額合計上限をいいます。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL] <https://www.sumcosi.com/>)(以下「新聞等」といいます。)において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

2 前記「2 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

3 申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定であります。

なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況等を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状況等の把握期間は、最長で2021年10月6日(水)から2021年10月15日(金)までを予定しておりますが、実際の発行価格等の決定期間は、2021年10月12日(火)から2021年10月15日(金)までを予定しております。

したがって、

発行価格等決定日が2021年10月12日(火)の場合、申込期間は「自 2021年10月13日(水) 至 2021年10月14日(木)」、払込期日は「2021年10月18日(月)」

発行価格等決定日が2021年10月13日(水)の場合、申込期間は「自 2021年10月14日(木) 至 2021年10月15日(金)」、払込期日は「2021年10月19日(火)」

発行価格等決定日が2021年10月14日(木)の場合、申込期間は「自 2021年10月15日(金) 至 2021年10月18日(月)」、払込期日は「2021年10月20日(水)」

発行価格等決定日が2021年10月15日(金)の場合は上記申込期間及び払込期日のとおり、となりますのでご注意ください。

4 国内一般募集の共同主幹事会社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMB C日興証券株式会社及びゴールドマン・サックス証券株式会社であります。

5 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとしします。

- 6 申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。
7 申込証拠金には、利息をつけません。
8 株式の受渡期日は、払込期日の翌営業日であります。

したがって、

発行価格等決定日が2021年10月12日(火)の場合、受渡期日は「2021年10月19日(火)」

発行価格等決定日が2021年10月13日(水)の場合、受渡期日は「2021年10月20日(水)」

発行価格等決定日が2021年10月14日(木)の場合、受渡期日は「2021年10月21日(木)」

発行価格等決定日が2021年10月15日(金)の場合、受渡期日は「2021年10月22日(金)」

となりますので、ご注意ください。

株式は受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振替により行われます。

(3) 【申込取扱場所】

後記「3 株式の引受け」欄の金融商品取引業者の本店及び全国各支店で申込みの取扱いをいたします。

(4) 【払込取扱場所】

店名	所在地
株式会社三井住友銀行 大阪本店営業部	大阪府大阪市中央区北浜四丁目6番5号

(注) 上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。

3 【株式の引受け】

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数	引受けの条件
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目9番2号	未定	1 買取引受けによります。 2 引受人は新株式払込金として、払込期日に払込取扱場所へ発行価額と同額を払込むことといたします。 3 引受手数料は支払われません。ただし、国内一般募集における価額(発行価格)と発行価額との差額は引受人の手取金となります。
SMB C日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号		
ゴールドマン・サックス証券株式会社	東京都港区六本木六丁目10番1号		
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号		
計	-	15,000,000株	-

(注) 引受株式数及び引受株式数の合計数(新規発行株式の発行数)は、発行価格等決定日に決定されます。

4【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
32,224,500,000	294,000,000	31,930,500,000

- (注) 1 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、消費税等は含まれておりません。
- 2 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2021年9月22日(水)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

(2)【手取金の使途】

上記差引手取概算額31,930,500,000円については、国内一般募集と同日付をもって取締役会で決議された海外募集の手取概算額上限96,038,500,000円と合わせた手取概算額合計上限127,969,000,000円について、786億円を2023年12月末までに当社の国内製造拠点(佐賀県伊万里市)における建屋及びユーティリティ設備に関連する設備投資資金に、残額を当該建屋における当社の300mm半導体用最先端シリコンウェーハの製造設備のための設備投資資金として2024年12月末までに充当する予定であります。

上記手取金は、具体的な充当期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

当社グループの300mm半導体用最先端シリコンウェーハの増強投資の方針について

当社グループは、半導体デバイスに使用される高品質のシリコンウェーハ製造において、大口径から小口径までカバーする幅広い製品展開力と技術力を有し、これらを最大限に活用し安定的な供給体制を構築することにより、社会の発展に貢献しております。

特に、顧客からの極めて厳しい品質・コスト要求に応える技術力の強化・向上に傾注し、半導体用シリコンウェーハ業界における地位の向上を図っております。

300mm半導体用シリコンウェーハの需要は、5G・スマートフォン・データセンター・車載向け半導体等の強い需要の継続を背景に、今後も堅調に拡大することが見込まれます。現状の当社グループの製造設備では供給が需要に追い付かない状況となっており、特に、半導体デバイスの性能向上を牽引する最先端のテクノロジーに対応した300mm半導体用最先端シリコンウェーハ市場は、より高い成長が見込まれています。

かかる状況を踏まえ当社は、その時々における300mm半導体用最先端シリコンウェーハ市場の需給予想や製造設備の新設・増設に要する時間等を考慮しながら、顧客に対する供給責任を果たすために顧客の需要に応じた段階的な増産(以下「逐次増産」という。)を適切に実施する方針を継続してまいります。また、今後の逐次増産は、経済合理性のある価格と従来の長期販売契約(2~3年程度)よりも長期間の契約に応じて頂ける顧客に対する供給を優先して実施してまいります。

最先端半導体の微細化技術は絶えず進化しており、新しいテクノロジーに対応した300mm半導体用最先端シリコンウェーハに要求される技術及び品質に対する顧客の要求はますます厳しくなっております。これらの要求水準を満たす製造ラインを構築するには、従来よりも高精度・高性能で且つ高価な製造加工装置及び検査装置等の関連設備を導入することが必要となります。

今回の資金調達には、当社グループの国内既存建屋内における増産スペースが尽きていることから、新たに建屋及びユーティリティ設備を建設した上で、逐次増産に対応できるよう製造設備を導入し、順次生産を開始できる体制を構築することを目的としております。

当社及び当社子会社であるSUMCO TECHXIV株式会社による総額2,287億円の設備投資について

当社及び当社子会社であるSUMCO TECHXIV株式会社は、2021年9月30日に総額2,287億円の設備投資を決定いたしました。当社グループの国内既存建屋内の増産スペースが尽きていることから、300mm半導体用最先端シリコンウェーハの逐次増産を継続し、供給責任を果たすため、当社において新たな建屋、ユーティリティ設備及び製造設備にかかる設備投資の実施を決定いたしました。併せて当社子会社であるSUMCO TECHXIV株式会社においても、建屋の増築、ユーティリティ設備及び製造設備にかかる設備投資の実施を決定いたしました。今後2022年より建屋の建設及びユーティリティ設備の設置を進め、2023年からは製造設備を導入のうえ順次生産を開始し、2023年内にはSUMCO TECHXIV株式会社の、2024年内には当社の本設備投資の完了を予定しております。(なお、2024年末までの両社の設備投資が本設備投資に限られるわけではありません。)

今般新たな建屋及びユーティリティ設備を導入することで、今後数年にわたり複数回の逐次増産に対応する設備投資を行うことが可能となります。

当社グループの主な設備投資計画の内容は、本有価証券届出書提出日(2021年9月30日)現在、以下のとおりとなっております。

会社名	設備の内容	投資予定額		資金調達方法	着手年月	完了予定年月	完成後の増加能力
		投資総額 (百万円)	既支払額 (百万円)				
提出会社 (株式会社SUMCO)	300mm半導体用最先端シリコンウェーハの対応設備(建屋及びユーティリティ設備の建設に関連する設備投資)	78,600	-	増資資金	2021年 10月	2023年 12月	(注)2
提出会社 (株式会社SUMCO)	300mm半導体用最先端シリコンウェーハの対応設備(製造設備に関連する設備投資)	122,900	-	増資資金及び自己資金	2021年 10月	2024年 12月	(注)2
SUMCO TECHXIV 株式会社	300mm半導体用最先端シリコンウェーハの対応設備(建屋及びユーティリティ設備の建設に関連する設備投資)	16,500	-	自己資金及び借入金 (注)1	2021年 10月	2023年 12月	(注)2
SUMCO TECHXIV 株式会社	300mm半導体用最先端シリコンウェーハの対応設備(製造設備に関連する設備投資)	10,700	-	自己資金及び借入金 (注)1	2021年 10月	2023年 12月	(注)2

(注)1 提出会社(株式会社SUMCO)からの子会社投融資

2 完成後の生産能力を合理的に見積もることは、困難であるため記載しておりません。

当社グループの台湾拠点における今後の設備投資について

当社グループは、今後も旺盛な需要の増加に対応するため、継続的な逐次増産が必要になると見込んでおります。顧客からの需要の増加に対応するべく、台湾においても供給責任を果たすために市場の成長に見合った段階的な増産を検討してまいります。国内の製造拠点と同様に、台湾の製造拠点においても既存建屋における生産能力は限界に達しております。従って台湾においても増産を継続する場合、新たな建屋及びユーティリティ設備の建設に伴う追加投資が必要になる見込みです。なお、当該追加投資が必要となった際の資金調達手段は未定であり、また、今回の国内一般募集及び海外募集による手取金を充当するものではありません。

第2【売出要項】

該当事項はありません。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

1 本邦以外の地域における当社普通株式の募集について

国内一般募集と同時に、当社普通株式の海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144 Aに従った適格機関投資家に対する販売に限ります。）における募集（海外募集）が、Morgan Stanley & Co. International plc、SMBC Nikko Capital Markets Limited及びGoldman Sachs Internationalを共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーとする海外引受会社（以下「海外引受会社」といいます。）の総額個別買取引受けにより行われます。また、当社は海外引受会社に対して追加的に発行する当社普通株式を取得する権利を付与します。

公募による新株式発行の発行株式総数は60,000,000株であり、国内一般募集株数（新規発行株式の発行数）15,000,000株及び海外募集株数45,000,000株（海外引受会社の買取引受けの対象株数37,174,000株及び海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の対象株数7,826,000株）を目処に募集を行います。その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で発行価格等決定日に決定します。

なお、国内一般募集及び海外募集のジョイント・グローバル・コーディネーターはMorgan Stanley & Co. International plc、S M B C日興証券株式会社及びゴールドマン・サックス証券株式会社（以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」といいます。）であります。

また、海外募集にあたり、海外の投資家向けには英文目論見書を発行しておりますが、その様式及び内容（連結財務書類を含みます。）は本書と同一ではありません。

2 ロックアップについて

国内一般募集及び海外募集に関連して、当社は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、発行価格等決定日に始まり当該募集に係る受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間（以下「ロックアップ期間」といいます。）中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換され得る有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を表章する有価証券の発行等（ただし、国内一般募集、海外募集及び株式分割による新株式発行等を除きます。）を行わない旨を合意しております。

上記の場合において、ジョイント・グローバル・コーディネーターは、ロックアップ期間中であってもその裁量で、当該合意の一部又は全部につき解除できる権限を有しております。

第3【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。

第4【その他の記載事項】

特に新株式発行届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。

・表紙に当社の社章  を記載いたします。

・表紙裏に、以下の内容を記載いたします。

1. 募集又は売出しの公表後における空売りについて

(1) 金融商品取引法施行令(以下「金商法施行令」といいます。)第26条の6の規定により、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」(以下「取引等規制府令」といいます。)第15条の5に定める期間(有価証券の募集又は売出しについて、有価証券届出書又は臨時報告書が公衆の縦覧に供された日のうち最も早い日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有価証券届出書の訂正届出書又は当該臨時報告書の訂正報告書が公衆の縦覧に供された時のうち最も早い時までの間(1))において、当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の2の2第7項に規定する私設取引システムにおける空売り(2)又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(3)の決済を行うことはできません。

(2) 金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り(2)に係る有価証券の借入れ(3)の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができません。

1 取引等規制府令第15条の5に定める期間は、2021年10月1日から、発行価格を決定したことによる有価証券届出書の訂正届出書又は臨時報告書の訂正報告書が提出され、当該訂正届出書又は当該訂正報告書が公衆の縦覧に供された時のうち最も早い時までの間となります。かかる有価証券届出書の訂正届出書及び臨時報告書の訂正報告書は、2021年10月12日から2021年10月15日までの間のいずれかの同一の日に提出されます。なお、上記臨時報告書及びその訂正報告書は、この目論見書により行う株式の募集と同時に決議された海外市場における株式の募集に関し提出されるものです。

2 取引等規制府令第15条の7各号に掲げる、次の取引を除きます。

・先物取引

・国債証券、地方債証券、社債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除きます。)、投資法人債券等の空売り

・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り

3 取引等規制府令第15条の6に定めるもの(売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け)を含みます。

2. 今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、引受人の引受株式数及び引受人の手取金をいいます。以下同じ。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(新規発行株式の発行数(国内一般募集株数)、海外募集株数、海外引受会社の買取引受けの対象株数、海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の対象株数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額、海外募集の手取概算額上限及び手取概算額合計上限をいいます。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL] <https://www.sumcosi.com/>) (以下「新聞等」といいます。)において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

・表紙の次に、以下の「会社概要」から「業績等の推移」までの内容をカラー印刷したものを記載いたします。

会社概要



基本情報

■ 商号	株式会社SUMCO (SUMCO CORPORATION)
■ 証券コード	3436
■ 設立	1999年(平成11年)7月30日
■ 本店	東京都港区芝浦一丁目2番1号
■ 資本金	138,718百万円(2021年6月30日現在)
■ 代表者	代表取締役 会長兼CEO 橋本 貢幸
■ 従業員数(連結)	8,199名(2020年12月31日現在)
■ 事業内容	半導体メーカー向けシリコンウェーハの製造及び販売
■ 上場証券取引所	東京証券取引所市場第一部

沿革

1999年 7月	住友金属工業株式会社(現 日本製鉄株式会社)、三菱マテリアル株式会社及び三菱マテリアルシリコン株式会社の共同出資により、株式会社シリコン ユナイテッド マニュファクチュアリングとして設立。
2001年 10月	300mmウェーハの生産開始。
2002年 1月	米国における持株会社としてSUMCO USA Corp.を設立。
2002年 2月	住友金属工業株式会社(現 日本製鉄株式会社)よりシリコン事業(シックス事業本部)の営業を譲り受けるとともに、三菱マテリアルシリコン株式会社と合併、同時に商号を三菱住友シリコン株式会社に変更。
2005年 8月	商号を株式会社SUMCOに変更。
2005年 11月	株式会社東京証券取引所市場第一部上場。
2006年 10月	コマツ電子金属株式会社(現 SUMCO TECHXIV株式会社)株式の公開買付けにより同社を子会社化。
2006年 10月	SUMCO Oregon Corp.を清算。
2007年 1月	SUMCO USA Corp.を清算。
2007年 12月	FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATIONが台湾証券交易所(証券取引所)に正式上場。
2008年 5月	株式交換の方法により、SUMCO TECHXIV株式会社を完全子会社化。
2008年 8月	会社分割の方法により、SUMCO TECHXIV株式会社の営業部門及び技術部門を当社が承継。
2011年 2月	当社尼崎工場閉鎖。
2012年 11月	ジャパンスーパーカーブ株式会社を吸収合併。
2013年 3月	SUMCOソーラー株式会社を清算。
2013年 7月	当社生野工場閉鎖。
2016年 3月	監査等委員会設置会社に移行。

グローバル・ネットワーク



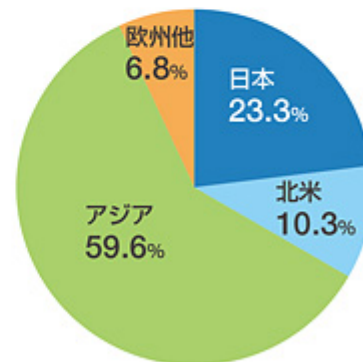
海外ネットワーク



国内ネットワーク



地域別連結売上高構成比 (2020年12月期)



※地域別売上高構成は、顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております

事業の内容



シリコンウェーハの製造～電子製品完成までの流れ



シリコンウェーハの製造工程

単結晶
引上工程

シリコンウェーハの原料は、採掘された珪石を精錬・精製した超高純度イレブンナイン(99.99999999%)の多結晶シリコンです。外部調達した多結晶シリコンを、当社は不活性ガス雰囲気の高純度石英ルツボの中で溶解し、独自の結晶育成技術で単結晶インゴットを製造します

ウェーハ
加工工程

ウェーハ加工工程では、シリコン単結晶のブロックを厚さ1mm以下にスライシング後、研削・鏡面研磨などの高度な加工工程を経て、超平坦・超清浄なシリコンウェーハに仕上げています

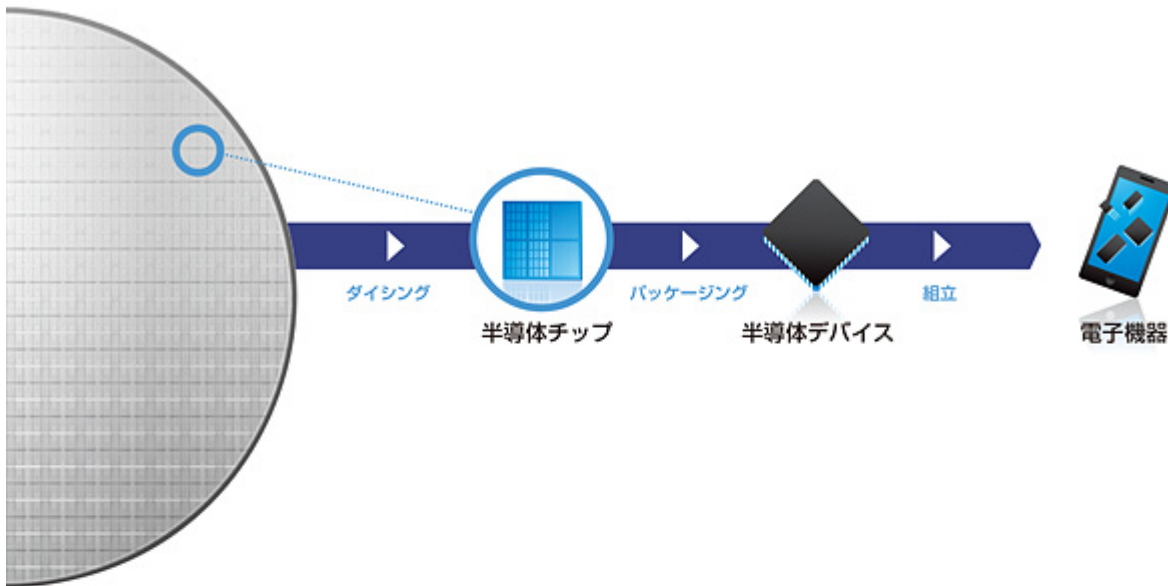


シリコンウェーハとは？

シリコンウェーハは、あらゆる電子機器の根源

シリコンウェーハは、日常生活で目にすることはありませんが、私たちの暮らしを豊かにするあらゆる電子製品に搭載されている半導体の製造に欠かせない材料で、実は生活に欠かすことができない製品です。様々な技術革新が電子機器を進化させ、私たちの暮らしを豊かにし、社会を進化させます。

その進化に必ず必要なシリコンウェーハの技術革新に挑戦し続ける企業、それがSUMCOです。



シリコンウェーハ需要を牽引する半導体の成長

データ通信量の増加



- テレワークの普及等でデータ通信量が飛躍的に増加し、データセンターのサーバーは益々必要になります

5Gスマートフォンの普及



- 超高機能（超高速・超大容量・超高画質）な5Gスマートフォンの普及が急速に進んでいます

HEV・EVの普及



- 地球温暖化防止に向けて、内燃車からハイブリッド車・電気自動車へのシフトが急速に進んでいます

自動運転の進展



- 自動運転のレベルが進歩するのに伴い、1台当たりの半導体使用量が増加しています

テレワークの定着



- コロナ禍で普及したテレワークは、今後もニューノーマルとして定着する見込みです

デジタルトランスフォーメーション (DX)



- AIやIoTを活用した生産革新とロボット導入による自動化が進んでいます

SUMCOの持続的な企業価値の向上



SUMCOの製品供給を通じたSDGsへの取組み

SUMCOはシリコンウェーハの高精度化を進め、半導体の進化をサポートすることで、SDGsの達成に貢献していきます。

SUMCOの高精度ウェーハを使った半導体

(メモリー半導体)	(ロジック半導体)	(パワー半導体)	(センサー半導体)
データを保持する役割を果たします 一時的に保持するDRAMと長期間保持するNANDがあります	演算を行う頭脳の役割を果たします	電力をコントロールする役割を果たします	画像や温度・圧力・速度などを検知する役割を果たします
PC、スマートフォン、サーバなどに搭載	PC、スマートフォン、サーバを中心にあらゆる情報端末機器に搭載	半導体のネジ・釘と言われるように、需要の裾野が広いのが特徴です	監視カメラ、自動運転などを中心に幅広く検知機器に搭載

高精度ウェーハの供給を通じた、産業の発展と人々の生活の質の向上への貢献

イノベーションの創出

メモリー半導体とロジック半導体の微細化をサポートして、IoT、AI、ロボットによる産業・技術革新とビッグデータの時代へ



スマートシティの実現

IoT社会の進展に必要なセンサー半導体用のウェーハを供給し、省エネで安心・安全なまちづくりを実現し、自動運転は、さらなる進化へ

省エネとクリーンエネルギーの普及

電力制御に不可欠なパワー半導体の進化をサポートして、省エネ機器をもっと普及、クリーンエネルギーの太陽光・風力をもっと当たり前へ



地球温暖化の防止

CO₂排出量の削減に向けた車載半導体の開発に参画し、ウェーハの提供を通じて低炭素化社会の実現へ

SUMCOビジョンと財務体質改善の実績



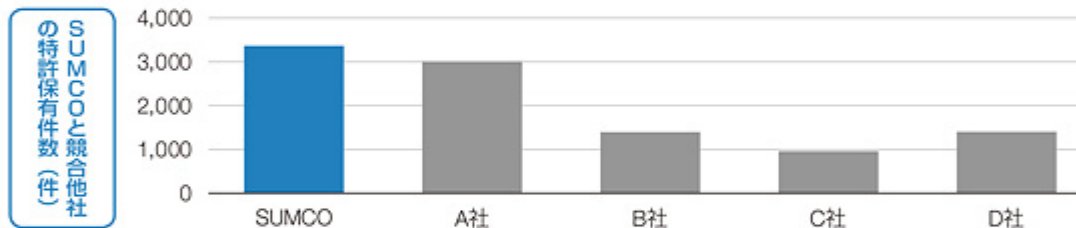
SUMCOビジョン

2012年4月、当社グループは、全社一丸となってエクセレントカンパニーを目指し、それを実現するために、「SUMCO ビジョン」を策定しました。SUMCO ビジョンは、当社の目指すべき姿として、次の4つの項目を掲げています。



SUMCOの保有技術

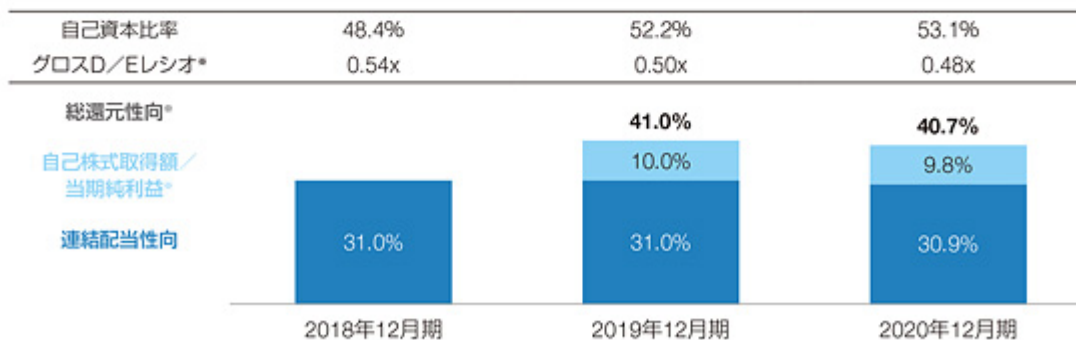
半導体用シリコンウェーハの主な製造プロセスには、単結晶引上・ウェーハ加工・特殊加工があります。SUMCOはそれぞれのプロセスにおいて最先端技術を持ち、競合他社比でも多数の特許*を取得しています。これらの技術をもとに、市場からの高度なニーズに対応しています。



*2011年初以降に日本・米国・中国・韓国・独国内において出願され、2020年12月末時点で有効又は登録された特許(当社がシリコンウェーハに関する特許であると判断したものに限り)であるものを、各国の公表資料から集計。競業他社についても当社判断にて選定

財務体質改善の実績

財務体質の改善により、2015年の公募増資時に掲げた自己資本比率50%以上、グロスD/Eレシオ0.5倍以下とする中期財務目標を2019年末に達成いたしましたので、株主還元策を見直し、従前からの連結配当性向約30%に加え、自己株式の取得により更に約10%の株主還元を2019年12月期及び2020年12月期に実施しました。なお、2021年12月期の期末配当及び自己株式取得については未定です。



*グロスD/Eレシオ=有利子負債÷自己資本。有利子負債=短期借入金+長期借入金+リース債務(流動負債・固定負債)

自己資本=株主資本合計+その他の包括利益(損失)累計額合計

*総還元性向=連結配当性向(一株当たり配当額÷一株当たり当期純利益)+(一株当たり自己株式取得額÷一株当たり当期純利益)

2020年12月期、2021年12月期に実施した自己株式取得を、各直前期の株主還元として計上

*当期純利益は親会社株主に帰属する当期純利益(連結ベース)を指す

業績等の推移



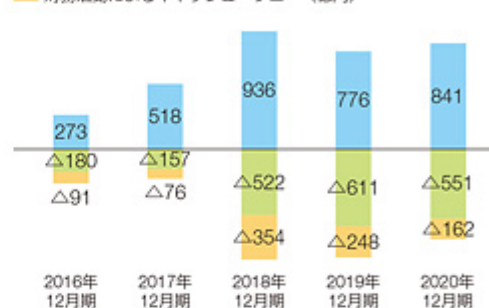
売上高

(億円)



キャッシュ・フロー

■ 営業活動によるキャッシュ・フロー (億円)
 ■ 投資活動によるキャッシュ・フロー (億円)
 ■ 財務活動によるキャッシュ・フロー (億円)



経常利益

■ 経常利益 (億円)
 ● 売上高経常利益率 (%)



自己資本利益率

(%)



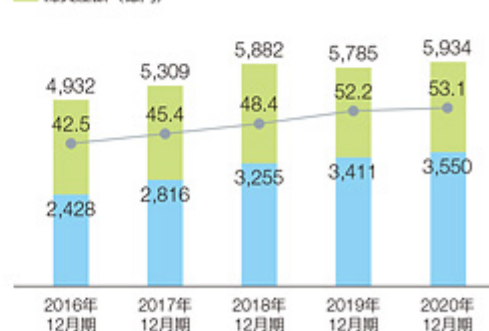
親会社株主に帰属する当期純利益

■ 親会社株主に帰属する当期純利益 (億円)
 ● 売上高当期純利益率 (%)



自己資本比率

■ 純資産額 (億円) ● 自己資本比率 (%)
 ■ 総資産額 (億円)



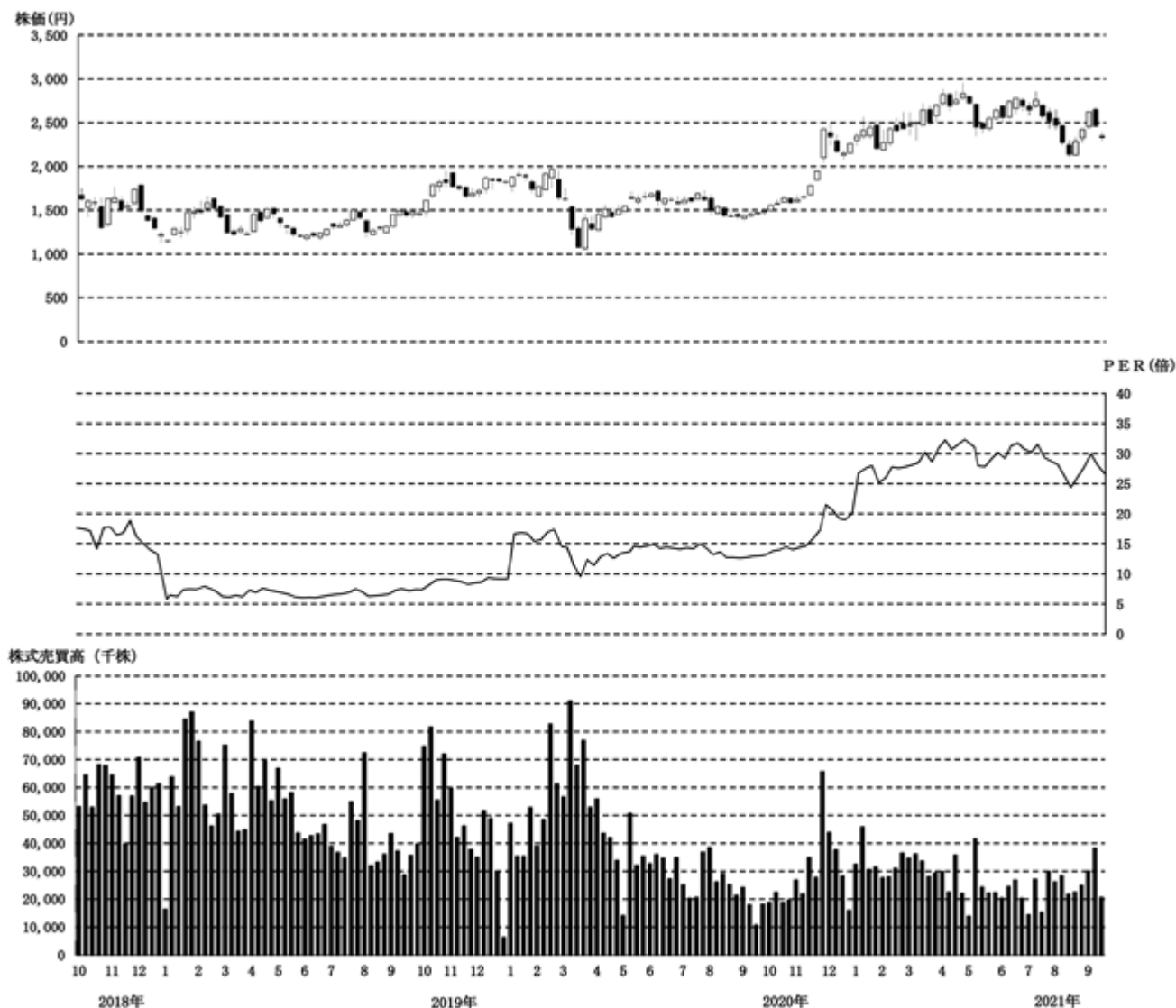
※1億円未満の金額は、切捨て表示としています
 ※上記は全て連結での財務数値を表示

・第一部 証券情報の直前に以下の内容を記載いたします。

(株価情報等)

1【株価、P E R 及び株式売買高の推移】

2018年10月1日から2021年9月24日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、P E R 及び株式売買高の推移(週単位)は以下のとおりであります。



- (注) 1 ・株価のグラフ中の1本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の4種類の株価を表しております。
 ・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。
 ・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。
- 2 P E Rの算出は、以下の算式によります。

$$P E R (倍) = \frac{\text{週末の終値}}{1 \text{ 株当たり当期純利益 (連結)}}$$

2018年10月1日から2018年12月31日については、2017年12月期有価証券報告書の2017年12月期の連結財務諸表の1株当たり当期純利益を使用。

2019年1月1日から2019年12月31日については、2018年12月期有価証券報告書の2018年12月期の連結財務諸表の1株当たり当期純利益を使用。

2020年1月1日から2020年12月31日については、2019年12月期有価証券報告書の2019年12月期の連結財務諸表の1株当たり当期純利益を使用。

2021年1月1日から2021年9月24日については、2020年12月期有価証券報告書の2020年12月期の連結財務諸表の1株当たり当期純利益を使用。

2【大量保有報告書等の提出状況】

2021年3月30日から2021年9月24日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出状況は、以下のとおりであります。

提出者(大量保有者)の氏名又は名称	報告義務発生日	提出日	区分	保有株券等の総数(株)	株券等保有割合(%)
ブラックロック・ジャパン株式会社	2021年5月31日	2021年6月4日	大量保有報告書 (注)1	3,425,400	1.18
ブラックロック(ネザerland)BV(BlackRock(Netherlands)BV)				569,600	0.20
ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited)				535,715	0.18
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited)				1,592,016	0.55
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors)				4,006,100	1.38
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)				3,776,647	1.30
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユークー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited)				643,868	0.22
株式会社三井住友銀行	2021年6月30日	2021年7月7日	大量保有報告書 (注)2	1,094,951	0.38
S M B C 日興証券株式会社				9,933,500	3.42
三井住友D S アセットマネジメント株式会社				3,707,300	1.28
株式会社三井住友銀行	-	2021年7月16日	訂正報告書 (注)3	-	-
S M B C 日興証券株式会社				-	-
三井住友D S アセットマネジメント株式会社				-	-
野村證券株式会社	2021年7月15日	2021年7月20日	変更報告書 (注)4	2,876,388	0.99
ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)				280,498	0.10
Nomura Global Financial Products Inc.				0	0
野村アセットマネジメント株式会社				16,952,864	5.84

提出者(大量保有者)の氏名 又は名称	報告義務発生日	提出日	区分	保有株券等の 総数(株)	株券等保有割 合(%)
三井住友トラスト・アセット マネジメント株式会社	2021年8月31日	2021年9月6日	大量保有報告書 (注)5	8,381,600	2.89
日興アセットマネジメント株 式会社				6,298,300	2.17
三菱マテリアル株式会社	2021年9月7日	2021年9月14日	変更報告書	25,596,400	8.82
三菱マテリアル株式会社	2021年9月14日	2021年9月22日	変更報告書	22,296,400	7.68
みずほ証券株式会社	2021年9月15日	2021年9月24日	大量保有報告書 (注)6	7,295,700	2.51
アセットマネジメントOne株 式会社				9,104,530	3.14

- (注) 1 ブラックロック・ジャパン株式会社、ブラックロック(ネザール)BV(BlackRock (Netherlands) BV)、ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited)、ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited)、ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors)、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ・エイ。(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)及びブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユークー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited)は共同保有者であります。
- 2 株式会社三井住友銀行、S M B C日興証券株式会社及び三井住友D Sアセットマネジメント株式会社は共同保有者であります。
- 3 当該訂正報告書は、2021年7月7日に提出(報告義務発生日 2021年6月30日)された大量保有報告書の記載内容の訂正に係るものであります。
- 4 野村証券株式会社、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)、Nomura Global Financial Products Inc.及び野村アセットマネジメント株式会社は共同保有者であります。
- 5 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び日興アセットマネジメント株式会社は共同保有者であります。
- 6 みずほ証券株式会社及びアセットマネジメントOne株式会社は共同保有者であります。
- 7 上記の大量保有報告書等は関東財務局に、また大量保有報告書等の写しは当社普通株式が上場されている株式会社東京証券取引所に備置され、一般の縦覧に供されています。

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

該当事項はありません。

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第22期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) 2021年3月25日関東財務局長に提出

2【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第23期第1四半期(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) 2021年5月14日関東財務局長に提出

3【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第23期第2四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) 2021年8月12日関東財務局長に提出

4【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2021年9月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2021年3月26日に関東財務局長に提出

5【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2021年9月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2021年9月30日に関東財務局長に提出

6【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2021年9月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づく臨時報告書を2021年9月30日に関東財務局長に提出

(注) なお、発行価格等決定日に本6の臨時報告書の訂正報告書が関東財務局長に提出されます。

7【訂正報告書】

訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を2021年4月5日に関東財務局長に提出

第2【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(訂正報告書により訂正された内容を含み、以下「有価証券報告書等」と総称します。)に記載された「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」及び「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2021年9月30日)までの間において変更及び追加がありました。以下の内容は、当該「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」及び「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、当該変更及び追加箇所については_____ 〆で示しております。

なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、下記の「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」及び「事業等のリスク」に記載されたものを除き、本有価証券届出書提出日(2021年9月30日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。また、当該有価証券報告書等に記載された将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

[経営方針、経営環境及び対処すべき課題等]

(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは「お客様と株主の期待に応え、従業員に幸せを与え、社会に貢献する、常に世界一のシリコンウェーハメーカーを目指す」という経営理念のもと、半導体デバイスに使用される高品質のシリコンウェーハ製造において、大口径から小口径までカバーする幅広い製品展開力と世界をリードする高い技術力を有し、これらを最大限に活用し安定的な供給体制を構築することにより、社会の発展に貢献してまいります。特に、顧客からの極めて厳しい品質・コスト要求に応える技術力の向上に傾注し、シリコンウェーハの高精度化を進め、各種の半導体の進化をサポートすることで、シリコンウェーハ業界における地位の維持・向上を図るとともに、イノベーションの創出、スマートシティの実現、省エネとクリーンエネルギーの普及、地球温暖化の防止など産業の発展と人々の生活の質の向上へ貢献してまいります。当社グループは、この基本方針のもと、事業基盤を更に強化し、事業の持続的成長を目指し、ステークホルダーの負託に応えてまいりる所存であります。

(2) 目標とする経営指標、中長期的な会社の経営戦略

半導体シリコンウェーハは、短期的な変動要因はあるものの中長期的には、データ通信量の増加、5Gスマートフォンの普及、HEV・EVの普及、自動運転の進展、テレワークの定着、デジタルトランスフォーメーション(DX)などの技術革新による半導体市場の成長とともに拡大していく見通しであります。とりわけ、当社が強みを持つ300mm半導体用最先端シリコンウェーハの需要は高水準かつ安定的に成長してきており、今後急速に拡大することが見込まれています。一方、200mmウェーハは、一時的に新型コロナウイルス感染症の影響による需要の低迷が見られましたが、車載・民生・産業向け需要の急速な回復により需給タイトな状況が継続するものと予想しております。このような環境の中、主力製品である300mmウェーハについては、微細化技術の進展とともにますます厳しくなる高精度化の品質要求に対応する技術開発・投資による更なる差別化を図ってまいります。また、生産能力を上回る需要の対応については、経済合理性を十分に検討のうえ規律ある設備投資を実施する所存であります。200mm以下のウェーハについては、市場環境に見合った適正な生産体制の充実を図ってまいります。また、コスト競争力の強化に加え、データ通信量の増加、自動運転の進展、デジタルトランスフォーメーション(DX)等、今後の需要拡大が期待される分野へ経営資源を集中し差別化を図ります。

なお、半導体シリコンウェーハは、市場環境の変化が大きい事業分野に位置しているため、引き続き収益の改善に努めるとともに、需要環境の変化に迅速かつ的確に対応できる企業体質の構築を図ってまいります。

また、当社グループは、財務体質の改善により、2015年の公募増資時に掲げた自己資本比率50%以上、グロスD/Eレシオ0.5倍以下とする中期財務目標を2019年末に達成いたしました。そのため、株主還元策を見直し、2019年12月期及び2020年12月期には、従前からの連結配当性向約30%に加え、自己株式の取得により更に約10%の株主還元を実施いたしました。なお、2021年12月期の期末配当及び自己株式の取得については未定です。

なお、当社グループは、社会課題の解決と持続的な企業価値の向上に向けて重点課題に取り組んでおります。当社はこれまでもCO2排出量、エネルギー使用量、化学物質使用量、産業廃棄物排出量、用水使用量等について削減目標を設けて取り組むほか、障がい者の積極的な採用を図ってまいりましたが、今後、新たにカーボンニュートラル及び女性活躍推進についての中長期的な目標を掲げ、活動を加速化してまいります。

(3) 経営環境及び対処すべき課題

足許の半導体用300mmシリコンウェーハ市場については、データ通信量の増加、5Gスマートフォンの普及等に牽引され、需給のタイト感が更に強くなると予想しております。また、200mmウェーハについても車載・民生・産業向けに旺盛な需要が続くと見込んでおります。このような環境のもと、当社グループでは、引き続き「SUMCOビジョン」に基づき、顧客の高精度化要求や製品の差別化に対応した技術開発により顧客での高いプレゼンスや評価を維持するとともに、AI導入による対応時間の短縮化、ロボット導入による自動化等の生産性の向上、価格適正化、及びコスト削減による損益の改善に努めてまいります。また、コロナ禍や米中貿易摩擦等の影響が懸念されるなか、市場環境の動きを慎重に注視してまいります。設備投資につきましては、顧客に対する供給責任を果たし、

その時々におけるウェーハ市場の需給予測や生産設備の新設・増強に要する時間等を考慮しながら、規律ある設備投資を適宜実施してまいります。2021年9月に決議した増産投資は300mm半導体用最先端ウェーハを対象に、経済合理性のある価格と従来の長期販売契約(2~3年程度)よりも長期間の契約に応じて頂ける顧客に対する供給を優先して実施してまいります。シリコンウェーハの主要原材料である多結晶シリコンにつきましては、市場の急激な変化に伴い、長期購入契約締結時の需要予測と消費見通しに乖離が生じたことにより、現在余剰在庫を保有しております。その残高は、2016年度末をピークに当社の生産量の増加により減少に転じており、中長期的には適正水準に回復する見込みであります。なお、原材料在庫を含む「原材料及び貯蔵品」の残高は、2020年12月末時点で、対前年度末比73億円減の1,421億円となっております。

<SUMCOビジョン>

1. 技術で世界一の会社
2. 景気下降局面でも赤字にならない会社
3. 従業員が生き生きとした利益マインドの高い会社
4. 海外市場に強い会社

[事業等のリスク]

有価証券報告書等に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があることと認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期につきましては、合理的に予見することが困難であるものについては記載しておりません。

なお、これらの記載は、当社グループに関するすべてのリスクを網羅したものではなく、記載された項目以外のリスクも存在します。また、以下の事項のうち将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2021年9月30日)現在において当社グループが判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

(1) 事業環境について

当社グループが製造及び販売するシリコンウェーハは、パソコン、スマートフォン、タブレット型端末といった携帯端末、自動車、及びその他民生品を含む各種製品に使用される半導体基板等に用いられることから、半導体デバイスの市場需要に大きく依存しています。そのため、シリコンウェーハの需要は、急速な技術革新の進展や製品の陳腐化、製品構成の急速な変化、製品価格の下落といった半導体やその周辺産業に特徴的な諸要因の影響を受けます。近時は半導体及びシリコンウェーハ市場のすそ野が急速に広まっているため、半導体デバイス市場と世界のマクロ経済の動向との相関関係は強まっており、新型コロナウイルス感染症の拡大、米中貿易摩擦や地政学上のリスクなどに基づく景気後退は、半導体製品の需要に影響を及ぼす可能性があります。

他方、データ通信量の増加、5Gスマートフォンの普及、HEV・EVの普及、自動運転の進展、テレワークの定着、デジタルトランスフォーメーション(DX)などの技術革新により、半導体デバイス及びシリコンウェーハの需要は中長期的には拡大すると見込んでおりますが、当社の期待通りにシリコンウェーハの需要が増加する保証はなく、実際の市況と異なる場合には、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、こうした事業環境の変動に対し、市場動向に迅速かつ確に対応できる企業体質の構築を図るとともに、財務体質の一段の強化に努めておりますが、かかる対策が奏功しない場合には、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 当社グループの製品について

当社グループの製品が用いられる半導体の価格は、製品の市場投入後の普及・販売数量拡大等の影響もあり、一般的に低下する傾向にあります。急激な需給バランスの悪化やその他の事由により想定以上に半導体製品の販売価格の低下が生じる場合、その基盤材料であるシリコンウェーハにも価格下落圧力が生じ、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループにおいては、AI技術の活用等による生産性向上や継続的な技術改善による歩留改善等の合理化により、当該製品価格の低下を想定した事業計画を策定し、市場変動への対応力を強めておりますが、かかる対策が期待された効果を生じない可能性があります。

なお、上記以外にも、重大品質クレームの発生による多額の費用・損害賠償の発生、若しくは信用棄損に伴う販売量・シェア低下や、大規模設備事故、ウイルス感染等の事由に起因する大規模システム障害等による製造の中断や大幅な遅延等若しくは歩留の低下や伝染病の蔓延、製造設備の故障、原材料の供給不足、若しくは物流の機能停止等の結果、当社の生産能力の喪失又は低下が生じる場合、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

これに対し、当社グループでは、顧客との継続的なコミュニケーションによる品質要求変化のタイムリーな把握及び継続的な技術改善、定期的な製造設備に対する予防保全の実施、また大規模システム障害対策としてファイヤーウォール設置やウイルス対策ソフトの定期的な更新、USBメモリー等の持ち込み制限等により、当社グループ全体の生産能力低下や製品の供給が困難となるリスクを未然に回避するよう努めておりますが、かかる対策が奏功しない場合には、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 他社との競合について

シリコンウェーハ市場は、多額の設備投資、主要顧客からの品質、価格及び納期等に関する厳しい要請、競合他社による生産能力の増強による需給バランスの悪化、技術革新の影響等の特徴があり、当社は、価格、品質、生産能力、製品ラインアップ、技術・サービスなどについて、主に他のシリコンウェーハ製造会社と世界的な競合関係にあります。これらの競合他社の多くは、大規模企業であり、当社に比して、資金力、技術、生産能力、価格競争力、顧客との関係等において当社より優位に立つ可能性があります。

また、競合他社間の統合や合併等により、競合他社が競争力を飛躍的に高める可能性もあり、当社の競争力が相対的に弱まった場合には、製品価格の引下げや売上の減少につながり、当社の事業展開や経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。また、仮に当社が競争力を強化できた場合であっても、当社の顧客の多くはシリコンウェーハの調達において事業継続の観点から複数のサプライヤーを確保する方針を採用するのが一般的であることから、当社の市場シェアの拡大には限界があります。

(4) 主要顧客について

半導体市場は、比較的少数の大手メーカーが市場の大部分を占めているため、当社の売上の相当部分は特定の主要顧客によるものとなっております。しかしながら、主要顧客が従前と同水準の購入量を継続する保証はなく、これらの主要顧客が、半導体の市況、米国と中国との間の緊張といった地政学的要因、景気の悪化又は顧客側の個別要因により、当社からのシリコンウェーハの購入量を大幅に削減する場合には、当社グループの事業展開や経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 顧客の与信管理について

当社グループは、顧客の与信管理には万全を期しておりますが、多額の売掛債権を有する顧客の財政状況が悪化し、期日通りの支払いが得られない場合、また倒産により売掛債権の回収が不能になる場合、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。当該リスクは一定程度、危険な兆候を予見することは可能であると認識していますが、必ずしも全てのリスクを回避できるとは言えません。

当社グループは、定期的に信用調査を実施し、顧客の財務状況や事業の安定性のリスクを管理する体制を構築しておりますが、かかる体制が十分である保証はありません。

(6) 原材料の調達について

当社グループは、シリコンウェーハの主要原材料である高純度多結晶シリコンについて、世界の主要な多結晶シリコンメーカーとの間で長期購入契約を締結し、原材料の安定調達を図ってまいりましたが、購入契約締結時の需要予想と消費見通しに乖離が生じたことから余剰在庫を保有しております。当該契約が終了し在庫量が適正な水準に回復するまでの間は、原材料コスト低減の機会が制約される可能性があります。また、原材料在庫を含む「原材料及び貯蔵品」の見通しについては、「1. 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(3) 経営環境及び対処すべき課題」に記載したとおりであります。事業環境の著しい変化等により、消費量が変動した場合、あるいは、会計上の対応が必要となる場合、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

以上の原材料調達にかかるリスクを鑑み、当社グループでは原材料在庫水準の適正化に努めておりますが、かかる対策が奏功する保証はありません。

(7) 主要製造設備の安定調達について

当社の主要製造設備には研磨機等、短期間で他の設備メーカーへの切り替えができない設備があり、これらの円滑な調達が困難な場合には、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。また、製造設備の納入期間の長期化、設備メーカーの供給能力の不足、価格の引き上げ等により、設備投資の製造への寄与が遅れる場合には、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。さらに、急激な景気変化、自然災害、感染症の拡大、地政学的な変化に伴う輸出制限等により製造設備の円滑な調達が困難な場合には、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

特に、当社が必要とする設備には、高度かつ専門的にカスタマイズされているものも多数あり、装置サプライヤーの数も少なく、生産能力も限られているため、当社が今後実施する生産能力増強のための新たな設備投資において、稼働や操業開始の遅れが発生する可能性があります。

これらのリスクの顕在化に備え、製造設備の安定的な調達を実現するため、当社グループでは、主要な装置サプライヤーとの協働による関係強化構築や中長期安定供給に関する情報共有化等により、サプライチェーン途絶のリスクの回避策を講じておりますが、かかる対策が奏功しない場合には、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(8) サプライチェーンについて

当社グループにおける諸資材の調達について、経済環境の急激な変動、自然災害及び設備事故等によりサプライヤーが操業停止又は倒産等の事態に陥った場合、諸資材の調達に支障を来し、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、複数のメーカーからの購買や在庫の積み上げ等、調達途絶リスクを回避する対策を講じておりますが、かかる対策が奏功しない場合には、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(9) 設備投資について

当社グループは、市況変動や顧客要求の変化等、半導体業界を取り巻く環境の変化により、将来的な設備能力の余剰化や既存・導入設備の陳腐化等の事由が生じた場合、事業展開や経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

半導体デバイス産業には変動性があるため、シリコンウェーハ市場の将来動向を正確に予測し、その動向に合わせた生産能力を計画することは困難です。そのため、市場の需要が当社の予想以上に増加した場合には、当社は需要に見合う生産能力を有しない可能性があり、その結果、販売強化の機会が失われ、顧客との関係に悪影響を及ぼしたり、市場シェアの低下をもたらす可能性があります。また、市場の需要に合わせて設備を増強させることとした場合でも、実際に増強が完了するまでにタイムラグがあるため、その間に市況が悪化した場合や競合他社の生産能力が当社の予測以上に増強された場合には過剰な生産能力が生じる可能性があります。加えて、最先端の技術に係る設備投資には多額の資金を要しますが、期待された品質・歩留が得られない場合には想定した生産量を確保できない可能性や減損を計上する可能性もあります。

また、「第一部 証券情報 第1 募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」に記載のとおり、当社グループは、建屋の建設、ユーティリティ設備の設置、及びウェーハ製造設備に係る設備投資を決定しております。しかしながら、資材供給の遅延、技術上の問題、人員不足、事故又は作業の停止等の事情により、かかる計画に遅延が生じる可能性があります。また、かかる計画の縮小、予算超過、シリコンウェーハの需要及び市場価格の低下その他の理由によりかかる計画が当社グループの期待に沿わない可能性もあります。さらに、2022年以降に300mm半導体用最先端シリコンウェーハについて製造能力を増強し、経済合理性のある価格と従来の長期販売契約(2~3年程度)よりも長期間の長期契約を締結する顧客に優先的に製品を供給する予定であるものの、半導体市況によっては当該長期契約どおりに製品を販売できない可能性や、将来も同様の条件で長期販売契約を締結又は更新できない可能性があります。

こうした設備投資に起因するリスクを防ぐため、中長期的なマクロ経済動向に基づく需要のチェックや、顧客との継続的なコミュニケーションによる顧客技術動向の把握等に基づき、設備投資を実施しておりますが、当社がシリコンウェーハの将来の市況を正確に予測することは容易ではなく、かかるリスクを払拭できる保証はありません。

(10) 資産について

当社は、シリコンウェーハの工場や製造設備など多くの固有資産を有し、今後も新工場の建設を含む設備投資により保有固定資産が増加することが見込まれます。かかる固定資産又は資産グループへの投資額を回収できない可能性がある場合には、固定資産について減損が生じる可能性があります。

減損の兆候の判断には、資産に対応する事業や製品ラインの将来キャッシュ・フローの大幅な減少、法令改正やビジネス環境の大幅な悪化、重要な資産グループにおける回収可能性の悪化、製品市場の成長率の低下などの要因を考慮する必要がありますが、これらの要因に不利な変化が生じた場合、当該資産の回収可能性に重大な影響を与え、固定資産の減損が必要になる等当社の経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社の保有する棚卸資産の価値が低下した場合、評価損が発生する可能性があります。

(11) 資金調達について

当社グループの金融機関からの借入の一部及びコミットメントライン契約には財務制限条項が付されており、財政状況の著しい悪化によりその財務制限条項に抵触し、当該契約の解約及び当該借入金の返還請求を受け期限の利益を失った場合には、当社グループの資金調達に影響を及ぼす可能性があります。

また、信用格付けの低下、金利水準や市場環境等の要因により当社グループが希望する時期又は条件により資金調達が実行できない場合には、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、対応策として、十分な手元流動性の確保に努めることに加え、新規借入については、足元の低金利を活用した固定金利建長期借入を主体とすることでリスク低減を図っております。今後も金利水準や市場環境等を踏まえた資金調達を行うとともに、取引先金融機関との良好な関係の維持を図ってまいります。しかしながら、かかる対策が奏功しない場合には、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(12) 技術及び研究開発について

半導体業界は、急速な技術革新が進む業界であり、半導体の高集積化、微細化や半導体用途の多様化、高度化等、当社グループのシリコンウェーハに対する顧客からの要求品質は多岐に亘り、かつ、高度化しております。当社グループは、かかる顧客からの要求に応えるため、中長期的に需要の拡大が見込まれる300mm半導体用最先端シリコンウェーハに関する技術、品種別ではエピタキシャルウェーハ等の高付加価値ウェーハ関連技術、さらに、次世代ウェーハ製品の関連技術等に重点をおいた研究開発活動を行っております。

しかしながら、研究開発活動において想定した効果を得られない場合や、他社に比べ技術開発が遅れた場合には、業界における技術進歩への対応に支障が生じ、顧客の要求に適應することが困難となり、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループが重点を置いている300mm半導体用最先端シリコンウェーハは、開発や量産が容易ではないため、当社グループの研究開発費用が想定よりかさむ場合や生産性の改善に時間を要する場合には、当社グループの収益に悪影響を及ぼす可能性があります。

高度化する顧客要求に応えられるウェーハ製品をタイムリーに供給するには、常に半導体業界の技術動向や顧客ニーズの把握に努め、さらに、ニーズを先取りした研究開発を推進する必要があります。当社グループでは、半導体業界や顧客の技術動向を整理し、研究開発部門に適時インプットする体制の強化を図るとともに、学会等の技術情報や大学との共同研究も活用しながら最先端の研究開発を行っております。また、高度な研究開発活動の遂行の為に、技術者の能力が重要であることは言うまでもなく、きめ細かな教育プログラムにより技術者育成を行っております。他社に遅れを取らず、顧客要求に応えるため、これらの体制強化を推進しております。しかしながら、かかる対策が奏功しない場合には、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(13) 知的財産権について

当社グループは、シリコンウェーハ業界において競合他社に対抗していくためには、特許権その他の知的財産権の確保が非常に重要であると認識しており、国内外において出願中のものを含めて多数の特許を保有しております。

しかしながら、知的財産権の保護が不十分であることにより技術的優位性を保てなくなるリスク、また当社が認識しない第三者の特許が既に成立している場合において、当該第三者より知的財産権を侵害しているとの事由により、使用差止及び損害賠償等の訴えを起こされるリスクがあり、これらのリスクが顕在化した場合は、営業、生産、販売面、財政状態を含む当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループは事業活動で使用する知的財産権の一部について第三者からライセンスを受けているところ、将来的に他の知的財産権についても第三者からライセンスを取得する必要性が生じる可能性があります。当社グループは、これらのライセンスの取得及び維持にあたり多額の費用が必要となる可能性があります。また、これらの技術により事業上優位に立つ保証もありません。

そのため、当社グループでは、他社の特許調査によりリスクの予見に努めるとともに、知的財産権の戦略的な確保、他社の特許権を回避する代替技術の開発等によりリスクを最小化するように努めていますが、かかる対策が奏功しない場合には、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(14) 海外展開について

当社グループは、全世界の主要な半導体メーカー等に対してシリコンウェーハを供給しており、日本国内に加えて、北米、欧州及びアジアにそれぞれ拠点を設置し生産・販売活動を展開しております。当社グループのこれらの生産・販売活動においては、各国及び各地域の経済・政治情勢、紛争、テロ、感染症の拡大、交通機関の遅延、インフラの停止・不足、労働条件の変更・人材難や災害等の発生により、工場操業の低下などの影響を被る可能性があります。また、税制、為替、関税、輸出入規制など各種規制の大きな変更、各規制当局の基準・慣行の違い等により、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

特に、米中貿易摩擦により、大幅な関税の引上げ、特定企業への制裁、特定の用途の製品に対する制限やライセンス要件の拡大が実施されており、国家の安全保障や経済成長に重要な役割を果たす半導体関連産業においては、主要な顧客の喪失やサプライチェーンの毀損など深刻な影響を受ける可能性があります。

また、各国のシリコンウェーハを含む半導体の国内製造の奨励政策は、当社製品の競争力を低下させ、当社の事業展開や経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、カントリーリスクの検討、複数拠点での生産体制の確立により機動的な生産配分を可能とし、国際情勢の変化に伴うリスクのヘッジに努めておりますが、かかる対策が奏功しない場合には、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(15) 情報管理について

当社グループでは、事業展開する上で欠かせない技術上又は営業上の機密情報や、事業活動を通じて取得した顧客等の様々なステークホルダーの機密情報・個人情報などを多数保有しております。サイバー攻撃等による不正アクセス、コンピュータウイルスへの感染、情報インフラの故障又は関係者による不正持出し等の事態に伴い保有する情報が滅失又は外部に漏洩した場合、競争力の低下、社会的信用の失墜又は責任追及等に発展し、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

情報の滅失・漏洩リスクを極力低減するため、当社グループでは、インターネットを経由した外部からのサイバー攻撃やウイルス感染に備え様々な対策を講じており、全社的なセキュリティ体制の向上を進めております。また、当社グループでは、情報管理に係る社内規定・ガイドライン等を制定し、情報管理に関するルールや情報セキュリティについて全従業員を対象に定期的な教育を実施しております。しかしながら、かかる対策が奏功しない場合には、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループでは、材料の調達、製品の製造、販売、配送等の各過程において、情報システムに大きく依存しております。当社グループの情報システムが効果的に運用されない場合、システムの更新や代替システムへの移行に問題が生じる場合、サイバー攻撃などによりこれらのシステムのセキュリティに重大なネットワーク障害が発生する場合、継続的で安全なシステムを維持できない場合には、顧客サービスの遅延や顧客との関係の悪化、業務効率の低下、問題改善のための多額の設備投資、当社グループの評判の低下等により、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。当社グループでは、こうした情報システムのリスクに対し、基幹システム及び周辺システムの二重化やバックアップサーバーの設置などを行うとともに、定期的なバックアップサーバーへの切り替え訓練などの対策を実施しております。しかしながら、かかる対策が奏功しない場合には、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(16) 法規制について

当社グループは、事業活動を展開している世界各国において、労働、租税、輸出入規制、製造物責任、競争法、環境、事業活動や投資を行うために必要な政府の許認可規制等の各種法規制の適用を受けておりますが、当社グループは必要な許認可等を取得及び維持できない可能性があり、仮に取得できた場合でも許認可等に付された一定の条件、制限や限定を遵守できなかった場合には、当社グループは罰金、違約金、追加費用の対象となったり、規制当局による許認可等の取消しを受ける可能性があります。また、今後、これらの法規制が強化され、又は法規制の運用・解釈が厳格化された場合、法規制遵守のための費用増加や当社グループの事業展開の制約により、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、社内規定に基づき、事業遂行上関係する各種法規制の主管部門を定め、各主管部門が法規制の制定・改廃状況を継続的にモニタリングし、迅速に対応する法令遵守体制を構築することで、法規制の強化等のリスクによる影響を最小限に抑えるよう努めておりますが、当社グループのこれらの取組みにより当該リスクの影響を完全に抑制できる保証はありません。

(17) 為替相場の変動について

当社グループは、製品の輸出等において外貨建て取引を行っており、また、連結財務諸表を作成するにあたって海外連結子会社の財務諸表を円換算していることから、為替相場の変動は当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、外貨建て取引の為替変動リスクを回避するため、定期的に為替予約取引を行っておりますが、かかる対策により当該リスクを十分に回避できる保証はありません。

(18) 環境規制等について

当社グループの事業は、主に製造拠点において、エネルギーの使用、排気ガスの排出、排水の排出、有害化学物質の使用及び保管、産業廃棄物の廃棄、土壌及び地下水の汚染の検査及び浄化等、環境に関する多くの国内外の法的規制を受けており、これらの規制に基づき一定の費用負担や賠償義務その他法的責任が生じる可能性があります。

また、近年においては、一般的にこれら環境等に関する規制は強化される傾向にあります。今後において環境等に関する新たな国内外の法規制等が制定される可能性は否定できず、そのような場合、当社グループにおいて、これら法規制等への対応のために新たな環境保全コストの負担や税負担等が生じることが予想されます。当社が現在又は将来の環境規制を遵守できなかった場合、当社に対する損害賠償請求や罰金の賦課、一定地域における生産・操業停止、当社の評判・信用の低下を招き、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

さらに、近年様々なステークホルダーや投資家からのESGへの取組みへの期待が高まっており、これによる新たな環境規制や義務に関する追加的コストは、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。また、「1. 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(2) 目標とする経営指標、中長期的な会社の経営戦略」に記載のとおり、当社は社会課題の解決と持続的な企業価値の向上に向けて重点課題に目標を掲げて取り組んでおりますが、かかる取組みが奏功する保証はありません。

今後の環境規制等の強化に伴うリスクに備え、当社グループでは、再生可能エネルギーの利用推進による温室効果ガス排出量の削減や、生産技術改善による規制対象物質使用量の削減等、環境負荷低減の取組みを進めておりますが、かかる取組みが奏功しない場合には、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(19) 自然災害、事故等の発生について

当社グループの各製造拠点において、台風、豪雨、地震、津波又は火山活動等の自然災害や、事故、火災、感染症、テロ等が発生した場合、設備の損壊や給水・電力供給の制限、人的被害等の不測の事態により生産が停止し、製品の製造・販売に支障を来す可能性があります。当社グループの主要製造拠点において、上記の自然災害、事故、火災等に見舞われた場合には、製造・販売活動に支障を来し、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

これら自然災害、事故等のリスクへの対策として、当社グループではBCP(事業継続計画)を策定し、設備耐震・免震対策、資材予備品の備蓄、防災備品・備蓄品の整備、操業再開手順の明確化、訓練等の対策を推進しています。これらの対策の進捗や内容見直しについては、毎年、全社的な会議であるBSC(Business Security Committee)で報告され、経営陣のレビューを受けています。しかしながら、かかる対策が奏功しない場合には、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(20) 企業買収について

企業買収を実施する場合、急速な事業環境の変化による買収した企業の急速な業績悪化、のれん減損といった不測の事態が生じ、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を受ける可能性があります。

当社グループは、企業買収の実施を検討する際には、買収先企業の財務内容等についてデューデリジェンスを行い、事前にリスク回避するよう努めてまいりますが、買収後に期待されたシナジー効果が実現しない等、投入した資本やその他の資源の投資を回収できない可能性があります。

(21) 新型コロナウイルス感染症について

足許の新型コロナウイルス感染症の世界的流行に伴い、当社グループの従業員の罹患による操業低下、サプライチェーンの毀損、世界的な経済活動の停滞等により当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、新型コロナウイルス感染症への対応として、感染リスクの徹底抑制のため、一部地区でのテレワーク勤務や感染予防対策、従業員のワクチン接種の奨励等、有効と考えられるあらゆる対策を実施してまいりますが、かかる対策が期待された効果を生じる保証はなく、かかる対策に多額の費用を要する可能性及び当社グループの生産性が低下する可能性があります。なお、現時点では各製造拠点で支障なく操業を維持しておりますが、仮に感染状況が拡大し、当社グループの一部の生産工程で集団感染が発生する等の事態により操業に影響が出た場合には、当該工程の勤務シフトの調整や人員再配置等により、操業や経営成績等への影響を最小限に抑えるべく対策を講じます。しかしながら、かかる対策が奏功しない場合には、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(22) 上記以外のリスクについて

当社グループは、事業環境の変化等により、以下のような事態が生じる場合、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼすことが想定されます。

事業環境の大幅な変化により事業及び組織の再構築等が必要となる事態が生じる場合。

退職給付債務の計算に関して、数理計算上の前提条件の大幅な変化が生じる場合。

経済環境の変化等により、収益が悪化し、又は将来の収益の見積りが大幅に変動する等により、会計上の対応が必要となる場合。

当社グループの事業に必要な人材を確保できない場合。

当社グループの製品の不具合等に起因する争訟やその他の争訟が生じた場合。

内部統制が有効に機能しない事態が生じる場合。

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

株式会社SUMCO 本店
(東京都港区芝浦一丁目2番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第四部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

第五部【特別情報】

該当事項はありません。